

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: 組立サイトにおけるモールド材の変更のご案内

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2009年9月10日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

MSG_Tactical Marketing

該当GPCN番号:

13689

変更内容:

中国の組立サイト(Tianjin)におけるモールド材を変更致します。なお、形状、機能、電気的特性には変更ございません。

変更理由:

これまで使用していたモールド材が生産中止となったため。

対象製品:

添付別紙をご参照ください。

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日：2009年11月09日随時切り替えいたします。

変更品の見分け方:

その他:

JPCN2009-0084 [PCN13689] に係る対象製品

MC13191FC
MC13191FCR2
MC13192FC
MC13192FCR2
MC13240FC
MC13240FCR2
MC13821FC
MC13821FCR2
MCHC908JW16FC
MCHC908JW32FC
MCHC908JW32FCR
MPC17511AEP
MPC17511AEPR2
MPC17511EP
MPC17511EPR2
SC540219FC
SC540219FCR2
SP104553FC